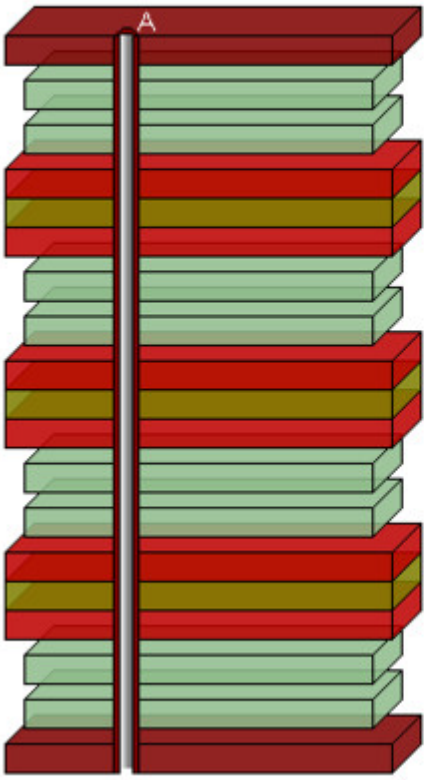
Multilayer 8 Lagen - 2,0 mm

Lagenaufbau

Ebene		Komponente	Dicke (mm)	Cu (my)	Typ
		Cu+galv.Cu		18	
1		Prepreg	0.109		2116
		Prepreg	0.109		2116
		Cu		35	
2		Tr-Lam	0.30		
		Cu		35	
3		Prepreg	0.109		2116
		Prepreg	0.109		2116
		Cu		35	
4		Tr-Lam	0.30		
		Cu		35	
5		Prepreg	0.109		2116
		Prepreg	0.109		2116
		Cu		35	
6		Tr-Lam	0.30		
		Cu		35	
7		Prepreg	0.109		2116
		Prepreg	0.109		2116
		Cu+galv.Cu		18	
8					

Presslingsdicke *	1,99	+/- 10%
Gesamtdicke inkl. galv. Cu u. Lötstoppmaske *	2,10	+/- 10%

Bemerkungen zum Lagenaufbau:

- * Dickenberechnung mit Basismaterial FR-4 ungefüllt bei 50% Kupferbelegung auf Innenlagen (abhängig von Basismaterialtyp, gewählter Kupferdicke und Kupferbelegung abweichende resultierende Isolations- und Enddicken)
- Dickentoleranz Basismaterial +/-10%
- minimale Kupferenddicken gemäß IPC 6012 aktuelle Ausgabe

KSG GmbH
Auerbacher Str. 3-5
09390 Gornsdorf

Tel. +49 (0)3721-266-0
Fax +49 (0)3721-266-175
E-Mail: sales@ksg-pcb.com

Multilayer 8 Lagen - 2,0 mm

Designrules zum Lagenaufbau

Durchgangslöcher [A] (Vias)	End-Ø	≥ 250 µm
	Viapad-Ø	≥ 550 µm
Leiterbild Außenlagen		
	Leiterbreite bei 9 µm Grundkupfer	≥ 80 µm
	Leiterabstand bei 9 µm Grundkupfer	≥ 100 µm
Standard	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer	≥100 µm
	Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 120 µm
	Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer	≥ 130 µm
	Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer	≥ 175 µm
	Leiterbreite bei 70 µm Grundkupfer	≥ 190 µm
	Leiterabstand bei 70 µm Grundkupfer	≥ 240 µm
Leiterbild Innenlagen		
	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer	≥ 65 µm
	Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 80 µm
Standard	Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer	≥85 µm
	Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer	≥ 100 µm

KSG GmbH
Auerbacher Str. 3-5
09390 Gornsdorf

Tel. +49 (0)3721-266-0
Fax +49 (0)3721-266-175
E-Mail: sales@ksg-pcb.com